

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-004

苏州晶方半导体科技股份有限公司 关于2024年日常关联交易执行情况及 2025年日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易情况已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议以及第五届审计委员会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次日常关联交易事项定价政策和定价依据符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第五届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、监事会表决情况

公司第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，关联监事已回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

3、审计委员会意见

公司第五届审计委员会第十六次会议于 2025 年 4 月 17 日审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，认为公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

4、独立董事专门会议意见

公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 17 日审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况的议案》、《关于公司 2025 年日常关联交易预计情况的议案》，认为公司 2024 年发生的上述关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和广大中小股东利益的情形。

(二) 公司 2024 年日常关联交易执行情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2024 年预计 发生金额	2024 年实际 发生金额	差异原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	500,000.00	145,900.34	需支付的技术使用费较少
项目开发费用等	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	30,000,000.00	51,429,187.14	项目开发及材料供应增加
设备开发与销售	苏州晶拓精密科技有限公司	20,000,000.00	5,392,385.49	设备开发与购置费用有所减少

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2024 年预计 发生金额	2024 年实际 发生金额	差异原因
封装服务费	苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	20,000,000.00	8,504,578.86	封装业务减少
办公室租赁费		558,713.52	558,713.52	/

(三) 公司 2025 年日常关联交易预计情况

1、采购商品、接受劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2025 年预计 发生金额	2025 年 1-3 月实际发生 额	2024 年实际发 生金额	占 2024 年同类业 务比例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
技术使用费	Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	300,000.00	9,552.72	145,900.34	100	需支付的技术使用费增加
项目开发、产品采购等	苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司	60,000,000.00	23,377,188.01	51,429,187.14	11.69	项目开发及材料供应增加
设备及部件开发与采购	苏州晶拓精密科技有限公司	20,000,000.00	583,539.82	5,392,385.49	24.65	设备开发与购置费用增加

- 1、技术使用费：为预计向 Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.支付的技术使用费。
- 2、项目开发费用、材料采购等：为预计向苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司支付的项目开发、产品采购费等。
- 3、设备及部件开发与采购：为预计向苏州晶拓精密科技有限公司支付的设备、部件的开发与购置费。

2、出售商品、提供劳务发生的关联交易

单位：人民币元

关联交易类别	关联方	2025 年预计 发生金额	2025 年 1-3 月 实际发生额	2024 年实际发 生金额	占 2024 年 同类业务比 例(%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
封装服务费	苏州思萃车规半 导体产业技术研 究有限公司	20,000,000.00	2,728,551.22	8,504,578.86	1.04	封装业务增加
租赁费及物 业费		1,445,473.44	287,471.70	558,713.52	4.31	租赁费增加
租赁费及物 业费	苏州晶拓精密科 技有限公司	54,495.41	0	54,495.41	0.42	-

- 1、封装服务费：预计为苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司提供封装服务收取的加工费

- 2、租赁费：向苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司收取的办公室租赁费
- 3、租赁费：向苏州晶拓精密科技有限公司收取的办公室租赁费

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.

创始人：A.Badih

注册地：3 Azrieli Center, Triangle Tower, 42nd Floor, Tel Aviv 6702301 Israel

主营业务：目前无实际经营业务

2、苏州思萃车规半导体产业技术研究有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 120 室

注册资本：1000 万元整

经营范围：半导体分立器件制造；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路芯片设计设计及服务；集成电路芯片及产品制造；光电子器件制造；工程和技术研究和实验发展；技术推广服务。知识产权服务（专利代理服务除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；照明器具制造；创业投资（限投资未上市企业）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、苏州晶拓精密科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：王蔚

注册地：江苏省苏州市工业园区长阳街 133 号 B 栋 121 室

注册资本：1000 万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；货物进出口；工程和技术研究和试验发展；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件制造；光电子器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件

件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

公司名称	与公司的关联关系
Engineering and IP Advanced Technologies Ltd.	公司监事担任其 CEO
苏州思萃车规半导体产业技术研究所有限公司	公司参股，持有其 30%的股份，公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人
苏州晶拓精密科技有限公司	公司董事长、总经理王蔚先生担任其法人

（三）前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

三、定价依据和定价政策

公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：

- （一） 交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。
- （二） 交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
- （三） 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
- （四） 交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
- （五） 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易的目的

以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司及全体股东的利益。

（二）交易对公司的影响

公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行与业务拓展。公司与各关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日